

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 โดย (1) กลุ่มผู้บริหาร (2) บริษัท เทคโนโลยี แอปพลิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TATL”) (3) Itochu Corporation และ (4) Multichip Assembly Inc. เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) โดยในระยะแรก บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 45 ล้านบาท ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุน โดยกลุ่มคุณสมนึก ไชยกุล ได้เข้าซื้อหุ้นที่กลุ่ม TATL ถืออยู่ทั้งหมด และในปีเดียวกันนั้น SIIX Singapore Pte. Ltd. ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 7 นอกจากนี้ ในปี 2547 บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท ส่งผลให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทประกอบด้วย (1) กลุ่มคุณสมนึก ไชยกุล (2) กลุ่มกรรมการและผู้บริหาร และ (3) พันธมิตรธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 56.54, 18.45 และ 13.66 ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งประกอบด้วยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) ระหว่างลูกค้าและทีมวิศวกรชั้นนำของบริษัท ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัทมีกำลังการผลิตในส่วนของ Microelectronic Module Assembly (“MMA”) ประมาณ 80 ล้านชิ้นต่อปี และในส่วนของ Integrated Circuit (“IC”) Packaging ประมาณ 700 ล้านชิ้นต่อปี โดยสามารถผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ในปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 3,500 ตารางเมตร และโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2548 และได้เปิดดำเนินการผลิตเมื่อปี 2549 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 22,000 ตารางเมตร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท มีดังนี้

- | | |
|-------------|--|
| ก่อนปี 2541 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทร่วมกับบริษัท GE Sensing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบุกเบิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ที่ใช้สำหรับระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) ในอุตสาหกรรมรถยนต์ จนสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ |
| 2541 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทได้ใช้เทคโนโลยี FCOG (Flip Chip on Glass) และ FCOF (Flip Chip on Flexible Circuit) สำหรับการผลิตและประกอบ LCD Module ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ▪ บริษัทได้ออกแบบและพัฒนา MMI (Man Machine Interface) Module เพื่อผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าในยุโรป |
| 2542 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001 สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, Flip Chip, Chip on Board (COB), Chip on Flexible Circuit (COF), Ball Grid Array (BGA) และ Surface Mounted Technology |

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- (SMT) และการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)
- บริษัทเริ่มต้นออกแบบและประกอบอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอง เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวอาจต้องมีการพัฒนาและดัดแปลงให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัท โดยอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย
 - Auto hot bar soldering machine (11 systems)
 - LCD heat seal bonding (10 systems)
 - Auto soldering metal shield machine (5 systems)
 - บริษัทรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัท อาทิเช่น Checkpoint Alcatel และ NEC สำหรับผลิตภัณฑ์ RFID และ LCD Module Assembly
- 2543
- บริษัทได้รับรางวัล Product Quality Assurance Notification (P.Q.A.) จาก Alcatel สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Alcatel โดยสินค้าจากบริษัทมีคุณภาพอยู่ในระดับไร้ข้อเสีย ซึ่ง Alcatel สามารถนำสินค้าเข้าสู่ระบบการผลิตโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้ง
 - บริษัทได้ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ NEC, Alcatel และ Sony-Ericsson ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตซึ่ง รวมถึง
 - FOG (Flex on Glass) alignment & pre-bonding machine (9 systems)
 - FOG final bonding machine (10 systems)
 - MMI Module testers ส่งออกให้กับลูกค้าในยุโรปมากกว่า 200 ชุด
- 2544
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภท TAB, Flip Chip, COB COF, BGA และ SMT และการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Captive Line Assembly)
- 2545
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นการปรับเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO
 - บริษัทได้เริ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องสแกนเนอร์ (Computed Tomography Scanner) ร่วมกับ GE Design Center ผู้ผลิตชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้ออกแบบในส่วนของ detector module ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับรังสีเอกซ์เรย์มาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัล
 - บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5 บาทต่อหุ้น
 - บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 182.50 ล้านบาทเป็น 273.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 18.25 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
 - บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2545
- 2546
- บริษัทประกอบ Color STN (Super Twist Nematic) LCD modules สำหรับจอโทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- 2547
- เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2547 บนเนื้อที่ 13 ไร่
 - ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนจาก 408.75 ล้านบาท เป็น 273.75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 27 ล้านหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ
 - ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 273.75 ล้านบาท เป็น 463.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 37.95 ล้านหุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10.95 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 3.65 ล้านหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 23.35 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ให้คณะกรรมการนำหุ้นที่เหลือนั้นมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้
 - ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 3,297,870 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 17.8 ล้านบาทให้แก่กรรมการและพนักงาน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 328.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547
 - บริษัทได้รับจ้างประกอบและออกแบบการเชื่อมต่อ TFT Display Module ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะนั้น
 - บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Hard Disk Drive กับลูกค้ารายใหญ่ของโลกบริษัทหนึ่ง
 - โรงงานแห่งที่ 2 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ LCD Module, Integrated Circuit (IC) และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 - บริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ (Thailand's Best Technology Innovation) สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจัดโดย Accenture, The Nation, Innovation Development Fund
 - บริษัทก่อตั้งตัวแทนการขายในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. ในซิลิคอนวัลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนตามกลยุทธ์ในการดำเนินการทางการตลาดและขยายฐานลูกค้า โดยพยายามติดต่อกู้ค่าโดยตรงมากขึ้น
- 2548
- บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่ม IC Packaging ในลักษณะ Standard Package ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในโครงสร้างรายได้ของบริษัท
 - โรงงานแห่งที่ 1 ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐาน ISO/TS16949 – Second Edition สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นระบบที่รับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาและออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ได้แก่ บริษัท Fabless รายหนึ่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ TouchPad สำหรับคอมพิวเตอร์ Note Book และ Touch Screen บนโทรศัพท์มือถือ

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- 2549
- บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงานแห่งที่ 2 โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตเริ่มต้นประมาณ 550 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อผลิตในลักษณะ Mass Production ให้แก่ลูกค้า
 - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 สำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศทางอเมริกา และยุโรป โดยสามารถส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 - โรงงานแห่งที่ 1 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad Module และ Optical Mouse Sensor และผลิตภัณฑ์ IC Packaging
 - บริษัทได้ร่วมมือทางการค้ากับ บริษัท Smart Electronics ในประเทศเยอรมัน เพื่อเป็นช่องทางในการหาลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคยุโรป
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Wireless Optical Sensor กับ EM Microelectronics (Swatch Group)
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก ON Semiconductor สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging
- 2550
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนจาก 463.50 ล้านบาท เป็น 344.99 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 23.70 ล้านหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ
 - ให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 344.99 ล้านบาท เป็น 736.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 78.20 ล้านหุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 41.40 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของหุ้นปันผล (2) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 36.80 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - บริษัทได้รับรางวัลทางด้านคุณภาพที่มีส่วนสูญเสียต่ำสุดจากการผลิตชิ้นส่วน Click Wheel Interface ที่ใช้ในเครื่องเล่น MP3 จากบริษัท Fabless รายหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก Impinj และ California Micro Device (CMD) สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Clear Pad Sensor กับ บริษัท Fabless รายหนึ่ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Micro-Electro-Mechanic Systems (MEMS) ซึ่งนำไปใช้กับอุปกรณ์การแพทย์ กับ GE Sensing
- 2551
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทต่อหุ้น เป็น 2 บาทต่อหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจาก 147,200,000 หุ้น เป็น 368,000,000 หุ้น
 - เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 36,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- บริษัทได้รับรางวัลคุณภาพที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management
 - บริษัทได้รับรางวัล Performance Achievement Award จาก ลูกค้าที่เป็นบริษัทผลิต Hard Disk
 - บริษัทได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชุดหัวตัดแยกคุณลักษณะเมล็ดพินหรือเม็ดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ แบบลมเป่า
 - บริษัทได้จดสิทธิบัตรระบบควบคุมแบบขนานสำหรับเครื่องคัดแยกสีผลิตภัณฑ์ เมล็ดพิน หรือเม็ดพลาสติก โดยใช้หน่วยสมองควบคุมหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนำไปใช้กับถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbag) กับ ELMOSSemiconductor AG
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEMS ซึ่งนำไปใช้กับ อุปกรณ์วัดความดันเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Fuel Tank Pressure Sensor) กับ BOSCH GmbH
- 2552
- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc เพิ่มเติมจำนวน 8 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบันบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทได้เริ่มจัดการทางการเงินรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552
 - บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรอัจฉริยะ Intelligent Card กับ Citela
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector)
 - บริษัทได้รับสัญญาสั่งซื้อจาก Micrel สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Subcontractor) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) โดยนอกจากบริษัทจะรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังมีการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อสนองต่อความต้องการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด สำหรับในช่วงปี 2546 - 2547 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนหน้าจอ LCD สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (LCD Module Assembly) ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งภายใต้ Microelectronics Module Assembly สำหรับในปัจจุบันถึงแม้ผลิตภัณฑ์หลักจะยังคงเป็นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) แต่จะมีความหลากหลายของชนิดและรุ่นผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยรายได้จากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ซึ่งรวมทั้งการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Hard Disk และ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในปี 2551 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2552 มีสัดส่วนร้อยละ 95.3 และร้อยละ 94.4 ของรายได้รวม ตามลำดับ

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทสามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี SMT COB COF FCOF และ FCOG (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 3.3.3) นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) โดยสามารถให้บริการทั้งการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมแบบพื้นฐาน (Standard Packaging) และประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมแบบขั้นสูง (Advanced Packaging) ซึ่งรวมถึงการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนำกระบวนการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Packaging) มาผสมผสานกันในเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตได้มีขนาดที่เล็กลงมาก

บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูงซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเพียงประมาณ 3 - 5 ไมครอน จึงสามารถกำหนดจุดวางชิ้นส่วนได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพการผลิตจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรพื้นฐานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 6 ปี จึงทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าว ประกอบกับทีมวิศวกรชั้นนำของบริษัทที่สามารถร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) จึงทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ที่มีความสามารถในการผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เป็นผู้ผลิตหน้าจอร์บบสัมผัสโดยใช้เทคโนโลยี Capacitive Touch Screen รายแรกของโลก ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ LG รุ่น Prada โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีความคุณสมบัติพิเศษสามารถสามารถจับจุดการสัมผัสได้หลายจุดพร้อมกัน (Multi Touch) สามารถตอบสนองต่อการสัมผัสจากผู้ใช้ได้ไวกว่า และมีความทนทานมากกว่า เทคโนโลยี Resistive Touch Screen แบบเดิม โดยต่อมาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการยุคใหม่รวมถึง iPhone, Google Android, Palm และ Blackberry Storm นอกจากนี้ จากการทำบริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่ครบวงจรจึงได้รับเลือกจากบริษัท บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องโปรเจกเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในลักษณะเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกของโลก

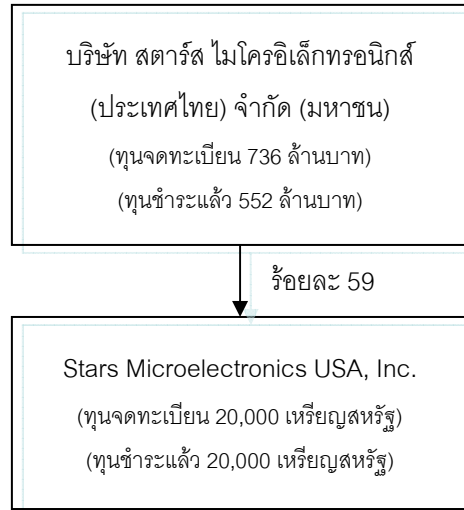
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทในปี 2551 มาจากการทำการตลาดโดยตรงกับลูกค้า คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 นอกเหนือจากนั้น บริษัทย่อย พันธมิตรและตัวแทนการตลาดจะทำการตลาดให้กับบริษัททั้งในส่วนของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อย คือ Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นตัวแทนจำหน่ายและทำการตลาดจัดหาลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของพันธมิตรและตัวแทนการตลาดของบริษัทมี 3 ราย ได้แก่ SIIX Corporation และ Itochu Corporation ในประเทศญี่ปุ่น และ Smart Electronics ในประเทศเยอรมัน ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมตลาดทั่วโลก นอกจากนี้ พันธมิตรและตัวแทนการตลาดยังสนับสนุนบริษัทในด้านการจัดหาวัตถุดิบและการจัดหาเครื่องจักรอีกด้วย

บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัท Smart Electronics และทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Stars Microelectronics Europe GmbH ในอนาคตเพื่อใช้ชื่อของบริษัทในการทำการตลาดในทวีปยุโรป และมีการถือหุ้นเพื่อให้สามารถมีส่วนในการกำหนดนโยบายธุรกิจที่สอดคล้องกับบริษัทได้ โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมต่อ บริษัท Smart Electronics เป็น

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จำนวน 50,000 ยูโร ตามสัญญาเข้าร่วมลงทุน โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะถูกแปลงสภาพเป็นทุนเรือนหุ้นต่อเมื่อบริษัทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท Stars Microelectronics Europe GmbH เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

2.3 โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท



- *Stars Microelectronics USA, Inc.* เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2548 มีสำนักงานอยู่ที่ ซิลิคอนวัลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19 ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้น ในบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc จากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 จำนวน 8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นร้อยละ 59 โดยผู้ถือหุ้นอื่นที่เหลือ คือ กลุ่มผู้บริหารของ Stars Microelectronics USA, Inc. ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทำให้ในปัจจุบันบริษัท Stars Microelectronics USA, Inc. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทได้เริ่มจัดทำงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ของปี 2552

2.4 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2549 - 2551 และงวด 6 เดือนแรกปี 2552 มีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

	ปี 2549		ปี 2550		ปี 2551		งวด 6 เดือนแรก ปี 2552	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
MMA – Hard Disk	6,923,575	86.87	10,253,933	87.75	10,173,347	83.76	3,565,478	77.09
MMA - Others	806,070	10.11	949,327	8.12	1,404,365	11.56	810,705	17.53
IC Packaging	220,019	2.76	397,437	3.40	430,087	3.54	174,670	3.78
รายได้จากการขายรวม	7,949,664	99.75	11,600,696	99.28	12,007,799	98.87	4,550,852	98.39
รายได้จากการบริการ ⁽¹⁾	17,603	0.22	52,265	0.45	119,475	0.98	45,941	0.99
รายได้อื่น ๆ	2,513	0.03	32,367	0.28	18,282	0.15	28,429	0.61
รวมรายได้	7,969,780	100.00	11,685,328	100.00	12,145,556	100.00	4,625,222	100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตามโครงสร้างรายได้ จะเห็นว่ารายได้จากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Hard Disk (MMA – Hard Disk) มีสัดส่วนมากถึงประมาณร้อยละ 85 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added หรือ VA ซึ่งหมายถึง รายได้จาก การขาย หักด้วยต้นทุนวัตถุดิบ) จะได้ภาพที่สะท้อนโครงสร้างและลักษณะการพึ่งพิงธุรกิจของบริษัทถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบหลักบางส่วนให้แก่บริษัท (Consign) เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนพิเศษและมีลักษณะเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกวัตถุดิบหลักดังกล่าวเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือแต่อย่างใด และ (2) การที่ลูกค้าของบริษัทมีการกำหนดแหล่งซื้อวัตถุดิบ หรือมีการกำหนดรายชื่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Vendor List หรือ AVL) โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบหลักเอง (Turnkey) ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นวัตถุดิบหลักเป็นต้นทุนการผลิตและสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณารายได้จากการขายจากมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนมูลค่าของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและประกอบของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีแตกต่างตามรายลูกค้า และรุ่นผลิตภัณฑ์ และการบันทึกบัญชีตามลักษณะการจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าว แต่อย่างใด

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มจำแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์

	ปี 2549		ปี 2550		ปี 2551		งวด 6 เดือนแรกปี 2552	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
มูลค่าเพิ่ม								
MMA – Hard Disk	163,273	30.02	215,592	26.09	223,976	21.30	80,543	16.16
MMA - Others	212,381	39.05	261,629	31.66	399,600	38.00	245,200	49.20
IC Packaging	148,090	27.23	264,437	32.00	290,191	27.60	98,217	19.71
มูลค่าเพิ่มรวม	523,744	96.30	741,658	89.76	913,766	86.90	423,960	85.08
รายได้จากการบริการ ⁽¹⁾	17,603	3.24	52,265	6.33	119,475	11.36	45,941	9.22
รายได้อื่น ๆ	2,513	0.46	32,367	3.92	18,282	1.74	28,429	5.70
รวมมูลค่าเพิ่ม	543,860	100.00	826,290	100.00	1,051,523	100.00	498,329	100.00

(1) รายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

2.5 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

2.5.1 มุ่งเน้นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต (Advanced Technology Machineries and Equipments)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับพื้นฐาน เช่น การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับดังกล่าวใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ดังนั้น การเข้ามาเป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายใหม่ในตลาดจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การแข่งขันด้านการตลาดมักจะใช้ราคาต่ำเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งภาวะการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้

บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูง ซึ่งบริษัทได้มีการลงทุนเครื่องจักรพื้นฐานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงไว้เป็นเวลากว่า 6 ปี อีกทั้งบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของบริษัทได้

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดในราคาที่สามารถแข่งขันได้ ทำให้ในปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าระดับบนที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการควบคุมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า และจัดให้มีการสุ่มตรวจคุณภาพของวัตถุดิบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต และสุ่มตรวจการทำงานของสินค้าก่อนการบรรจุสินค้าเพื่อส่งให้กับลูกค้า เพราะเหตุนี้ทำให้ทางบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้า โดยทางบริษัทได้รับรางวัลทางด้านคุณภาพที่มีส่วนสูญเสียต่ำสุดจากการผลิตชิ้นส่วน Click Wheel Interface ที่ใช้ในเครื่องเล่น MP3 จากบริษัท Fables รายหนึ่ง ในปี 2550 และรางวัลคุณภาพที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากบริษัท NEC Infrontia Thai Limited ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน (Supplier) ในกิจกรรม Total Supplier Chain Management ในเดือนเมษายน ของปี 2551

บริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวกับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประกอบกับการเข้าร่วมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ และการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทที่มีวิสัยพัฒนาของตนเอง และยังมีกรร่วมมือกับลูกค้า ในการทำการวิจัยและร่วมคิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ๆ รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ (Joint innovation) เพื่อยกระดับตัวเองเป็นพันธมิตรทางการวิจัยพัฒนา เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่ถาวรมากขึ้น ร่วมกับการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ด้วย

2.5.2 มุ่งเน้นการรักษาอัตราการเติบโตของฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตในการประกอบธุรกิจโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราการเติบโตของฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตโดยรวมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวน ตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตลาดและหาลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ และเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปลายทางให้มากขึ้น โดยใช้ทั้งการแต่งตั้งบริษัทตัวแทน และการจัดตั้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายเอง เช่น ดังที่ได้มีการจัดตั้งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและทำการตลาดจัดหาลูกค้าในอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการหาลูกค้ารายใหญ่เพิ่มให้แก่บริษัท เช่น On Semiconductor ซึ่งมีการซื้อผ่านบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. และ GE Sensing ซึ่งบริษัท Stars Microelectronic USA, Inc. ได้เป็นผู้จัดหาลูกค้ารายนี้มาให้ แต่จะมีการสั่งซื้อโดยตรงกับทางบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะหาลูกค้าใหม่ด้วยตนเองอีกด้วย

บริษัทได้มีการรับงานสำหรับการร่วมพัฒนา และ/หรือ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าใหม่จำนวน 5 ราย เพื่อผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดดูหัวข้อ 6. โครงการในอนาคต สำหรับลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใหม่) โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่ ได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2552 และคาดว่าจะมีกำลังการผลิตส่วนเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวประมาณ 1,300,000 ชิ้น ในครึ่งหลังของปี 2552 นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะอัตราการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะมีจำนวนชิ้นเพิ่มสูงขึ้นในปี 2553 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะอัตราการเติบโตโดยรวมจะมีอัตราการขยายตัวมากกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีแผนงานที่จะร่วมกับลูกค้าในการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้

หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ดังเช่น การที่บริษัทได้มีการร่วมกับ บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ในการร่วมกันพัฒนาและประยุกต์ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์เลเซอร์พกพา (Portable Laser Projector) ไปบรรจุเป็นส่วนประกอบในโทรศัพท์มือถือในอนาคต ซึ่งการนำผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในโทรศัพท์มือถือนั้น จะเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Multimedia ในโทรศัพท์มือถือไป การร่วมออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะได้รับความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลงานจากการร่วมออกแบบและพัฒนาที่ลูกค้าจะเป็นการรักษาให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทต่อไปในระยะยาวต่อไป

2.5.3 มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมให้สูงขึ้น

บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาจำนวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ ซึ่งได้แก่ เช่น การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Control Board) และมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า ได้แก่ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) ประเภทอื่น และการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging)

บริษัทได้มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอื่น ที่สอดคล้องและรองรับกับการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวม กล่าวคือ บริษัทจะมุ่งเน้นการร่วมพัฒนา และ/หรือ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง การที่บริษัทเน้นการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูง และการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) กับลูกค้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนให้บริษัทสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นในการดำเนินธุรกิจโดยรวมให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ การที่บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัว (diversify) ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จากการทำ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจสองธุรกิจนี้ จะสามารถเกื้อหนุนกันทำให้บริษัทสามารถให้บริการบริษัทลูกค้าอย่างครบวงจรมากขึ้น และทำให้บริษัทมีปริมาณการรับจ้างผลิตและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วย อีกทั้งธุรกิจการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) นั้นมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ที่ยาวกว่าธุรกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) มาก โดยมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส่วนมากยาวนานกว่า 5 ปี ทำให้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้ และนอกจากนี้ การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ยังมีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าด้วย อันจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว